

**深圳秋田微电子股份有限公司**  
**关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目的实际情况，对募投项目进行调整。

本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据相关规定，本事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

**一、募集资金的基本情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳秋田微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]10号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币37.18元，募集资金总额为人民币743,600,000.00元，扣除发行费用人民币（不含税）49,768,867.92元，实际募集资金净额为人民币693,831,132.08元，其中超募资金人民币19,683.73万元。募集资金已于2021年01月22日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年01月25日出具“天健验[2021]3-2号”《验资报告》，确认募集资金到账。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存

放和使用进行专户管理。

## 二、募集资金投资项目实际使用情况

截至2022年12月31日，公司募集资金投资项目实际使用情况如下：

单位：人民币万

元

项目名称	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	达到预定可使用状态日期
承诺投资项目				
触控显示模组赣州生产基地项目	28,582.69	7,928.14	27.74%	2024年09月30日
新型显示器件建设项目	6,399.34	603.36	9.43%	2023年09月30日
电子纸模组产品生产线项目	4,624.19	140.47	3.04%	2024年03月31日
研发中心建设项目	4,093.16	304.39	7.44%	2024年03月31日
补充流动资金	6,000.00	6,000.00	100.00%	-
承诺投资项目小计	49,699.38	14,976.35	-	-
超募资金投向				
深圳产业基地	19,683.73	29.80	0.15%	2023年12月31日
超募资金投向小计	19,683.73	29.80	0.15%	-
合计	69,383.11	15,006.16	-	-

截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金人民币15,006.16万元（其中包括：置换预先投入募投项目的自筹资金39,628,374.59元及已支付发行费用的自筹资金3,951,886.79元，共计43,580,261.38元），募集资金专户余额合计人民币57,314.54万元（含扣除手续费后的相关利息收入及理财收益）。

## 三、本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的情况

### （一）部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的情况

#### 1、部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的具体情况

公司基于对未来发展战略及业务整体布局优化的考虑，提高募集资金使用效率，拟对募投项目“研发中心建设项目”的实施地点进行调整。同时，由于募投项目“研发中心建设项目”的实施地点将进行变更，基于公司自身发展战略和业务开展特性的考虑，公司拟相应调整“研发中心建设项目”的实施方式。具体变

更情况如下：

研发中心建设项目	变更前	变更后
实施地点	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区	深圳市龙岗区园山街道（宗地号为G08406-0133的土地）
实施方式	深圳租赁与装修厂房建设	深圳产业基地自有厂房建设

由于公司拟对“研发中心建设项目”的实施地点、实施方式进行变更，为了保障募投项目的顺利实施，进一步提高募集资金使用效率，公司综合考虑市场、行业环境的变化及公司实际情况，拟在项目投资总额不变的前提下同步调整“研发中心建设项目”的内部投资结构，以更好地推进募投项目的实施。具体情况如下：

调整前		调整后	
工程或费用名称	投资估算金额 (万元)	工程或费用名称	投资估算金额 (万元)
1 建设投资	4,093.16	1 建设投资	4,093.16
1.1 软硬件设备投资	3,334.45	1.1 软硬件设备投资	3,334.45
1.1.1 新增设备投入	2,788.68	1.1.1 新增设备投入	2,788.68
1.1.2 新增软件投入	545.77	1.1.2 新增软件投入	545.77
1.2 场地投入	639.50	1.2 场地投入	495.50
1.2.1 场地租赁	144.00	1.2.1 场地租赁	-
1.2.2 装修费用	495.50	1.2.2 装修费用	495.50
1.3 预备费	119.22	1.3 预备费	263.22
<b>项目总投资</b>	<b>4,093.16</b>	<b>项目总投资</b>	<b>4,093.16</b>

注1：本次内部投资结构调整仅涉及将场地租赁投入调整至预备费，项目总投资不变。

注2：若出现尾数差异为四舍五入原因造成。

## 2、部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构的原因

公司此次变更后的实施地点为深圳市龙岗区园山街道（宗地号为G08406-0133的土地），该地段为公司竞拍取得用于投资建设深圳产业基地的用地位置。公司“研发中心建设项目”变更实施地点主要系公司根据战略规划及实际需要进行的调整，可充分利用深圳产业基地的地理优势，结合公司资源、资金、技

术、人才等资源优化配置的需求，实现统筹管理和深度发展，提高管理水平和运营效率，符合公司经营发展需要。

本次变更“研发中心建设项目”实施方式并调整内部投资结构，系基于公司长远发展规划，在不改变募投项目计划投资总额的情况下进行的实施方式及项目内部投资结构局部调整。本次内部投资结构调整仅涉及将场地租赁投入调整至预备费，项目总投资不变。在深圳产业基地自有厂房基础上实施“研发中心建设项目”，符合公司成本与效益最优化的要求，有利于改善办公环境，吸引招募更多合适的研发技术人才。

综上，本次调整系结合公司资源、资金、技术、人才等资源优化配置的需求，根据项目实施的实际情况对募集资金投资项目的实施地点、实施方式、内部投资结构作出的审慎调整，符合公司战略规划和业务发展需要，旨在提高公司管理水平和运营效率，实现公司统筹管理和深度发展，有利于进一步提升公司综合竞争力，同时有利于提高募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益。

## （二）募投项目延期情况

### 1、募投项目延期的具体情况

项目名称	调整前 达到预定可使用状态时间	调整后 达到预定可使用状态时间
触控显示模组赣州生产基地项目	2024年09月30日	2025年12月31日
新型显示器件建设项目	2023年09月30日	2025年12月31日
电子纸模组产品生产线项目	2024年03月31日	2025年12月31日
研发中心建设项目	2024年03月31日	2025年12月31日
深圳产业基地	2023年12月31日	2025年12月31日

### 2、募投项目延期的原因

公司自“深圳产业基地”项目立项以来，积极推进选址、用地土地的招拍挂和环评、安评等备案手续的办理工作，截至2022年12月31日，相关手续仍在办理中，预计将于2023年06月启动土方平整工作。由于“深圳产业基地”项目所涉建设用地流转采用土地线上招拍挂程序且属原始地貌出让，导致土地使用权属转让流程及前期开发手续的办理过程较为复杂，耗时长于预期。同时，为了满足智能化生产的要求，厂房建设、工艺布局及环评等要求提升。基于上述情况，公司结

合项目的实际进展及不可预期因素的影响，充分考虑项目建设周期，基于审慎性原则，拟将“深圳产业基地”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

由于募集资金投资项目“研发中心建设项目”的实施地点将调整到“深圳产业基地”项目所属地块，基于“深圳产业基地”目前的实际情况，同时涉及实施方式和内部投资结构发生变更，导致“研发中心建设项目”无法在原预定可使用状态的时间内完成，因此将达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”前期在实施过程中受到经济环境、市场环境等客观因素的影响，项目建设过程中拟采购的设备需要一定的采购周期和安装调试过程，设备到位时间预计有所延后。为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司充分考虑项目建设周期，经审慎研究，拟将“触控显示模组赣州生产基地项目”、“新型显示器件建设项目”和“电子纸模组产品生产线项目”达到预定可使用状态日期调整为2025年12月31日。

### （三）募投项目调整前后的具体情况

项目调整前后情况对比如下：

项目名称	调整事项	调整前	调整后
承诺投资项目			
触控显示模组赣州生产基地项目	达到预定可使用状态日期	2024年09月30日	2025年12月31日
新型显示器件建设项目	达到预定可使用状态日期	2023年09月30日	2025年12月31日
电子纸模组产品生产线项目	达到预定可使用状态日期	2024年03月31日	2025年12月31日
研发中心建设项目	实施地点	深圳市龙岗区园山街道荷坳金源工业区	深圳市龙岗区园山街道（宗地号为G08406-0133的土地）
	实施方式	深圳租赁与装修厂房建设	深圳产业基地自有厂房建设
	达到预定可使用状态日期	2024年03月31日	2025年12月31日
超募资金投向			
深圳产业基地	达到预定可使用状态日期	2023年12月31日	2025年12月31日

### 四、本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投

## 项目延期对公司的影响

本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项是公司根据未来发展战略及业务整体布局优化需要作出的审慎调整，有利于节省开支、提高募集资金使用效率。本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项未改变募投项目的投资内容、募集资金投资用途，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响。

## 五、履行的相关审核程序

公司于2023年04月19日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议分别审议通过了《关于部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的议案》，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

## 六、董事会、独立董事、监事会及保荐机构意见

### （一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项，符合公司发展规划和实际需要，是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定。因此，董事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项。

公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项如需履行有关部门的备案或审批等程序，公司将按照相关法律法规及规定执行。

### （二）独立董事意见

公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项是公司根据发展战略和长远规划作出的审慎决定，符合公司募集资金投资项目实际运作需要和投资计划，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合公司的整体发展规划及股东的长远利益。上述事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《上市公司监管指引第2号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》与公司《募集资金管理制度》等的有关规定。因此，独立董事一致同意公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项。

### （三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项，是公司根据募投项目实施情况和所面临的外部环境作出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，保障募投项目的顺利实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不会对公司目前的生产经营产生重大不利影响，有利于公司的长远发展。因此，监事会同意公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项。

### （四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，履行了相应的审议程序；公司本次部分募集资金投资项目延期符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关规定。公司本次对部分募集资金投资项目的延期是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期事项无异议。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、国信证券股份有限公司关于深圳秋田微电子股份有限公司部分募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投资结构及募投项目延期的核查意见。

特此公告。

深圳秋田微电子股份有限公司董事会

2023年04月20日